

HumiSeal®

THERMAL PAD HUMISEAL®



Cabiotec

Ridurre la temperatura di funzionamento dei componenti elettronici, ovvero dissipare il calore (per esempio tra un dissipatore e un processore), è fondamentale e per farlo è necessario utilizzare materiali termicamente conduttivi.

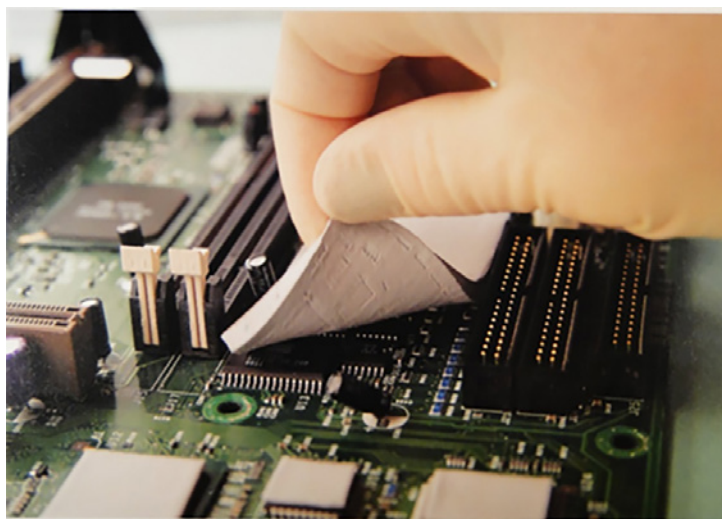
Il surriscaldamento dei componenti può provocare malfunzionamenti o l'arresto del dispositivo. Ridurre la temperatura superficiale del componente, ne aumenta la durata di vita. *I thermal pad sono il vostro alleato nella gestione termica...*

PERCHÉ I THERMAL PAD?

Gli alleati della **gestione termica**

I thermal pad di HumiSeal® sono materiali ideali a creare un'interfaccia termica e svolgono un ruolo chiave nella dissipazione del calore generato dal componente, senza formare le sacche d'aria tipiche dei grassi che sono le principali barriere al trasferimento di calore.

I thermal pad sono morbidi e "appiccicosi": questo permette loro di conformarsi perfettamente anche a superfici irregolari



I Thermal Pad HumiSeal® offrono **prestazioni migliori** del grasso tradizionale! Hanno una **maggiore durata** e, a differenza del grasso che scaldandosi tende a migrare verso i lati, **mantengono la loro forma** e le loro caratteristiche per tutto il ciclo di vita.

Applicazioni



- Trasformatori a bassa e media frequenza (AC/DC)
- Quadri di potenza
- Schede controllo motori
- Trasformatori planari e induttivi
- Inverter energie rinnovabili e non
- Moduli di memoria ad alta capacità per applicazioni grafiche e video
- Display a LED e illuminazione generale
- Relè a stato solido
- Telecomunicazioni
- Automotive
- Componenti di potenza di tipo TO

QUALE SCEGLIERE?

Per la scelta dei **thermal pad** bisogna considerare:

1. LA **DISTANZA** TRA IL COMPONENTE E IL DISSIPATORE DI CALORE
Se compresa tra 0,10mm - 5,0mm: è consigliato l'uso di thermal pad.
2. LO **SPESSORE** - Spesso o sottile
I thermal pad sottili offrono prestazioni migliori (vedi tabella sotto)
3. **CONDUTTIVITÀ TERMICA** (W/mk)

	ADESIVO MONOLATO	CONDUTTIVITÀ TERMICA (W/MK)	ADESIVO DOPPIO LATO	CONDUTTIVITÀ TERMICA (W/MK)	CARATTERISTICHE DELLO SPESSORE
THERMAL PAD SOTTILI 0,25-2MM Hanno un supporto in fibra di vetro per una maggior resistenza meccanica	TP-2260HP	1.6	TP-3500	3.3	Prodotto ad alte prestazioni e a prezzi competitivi: da 0,25-2.0 mm sono gli spessori più utilizzati. I thermal pad sottili hanno una conduttività termica maggiore.
	TP-3560	3.3	TP-2200HP	1.6	
	TP-1562	0.8	TP-1502	1.1	
	TP-2860	2.8	TP-3500 Soft	3.6	
	TP-3560 Soft	3.4			
THERMAL PAD SPESSI 2-5MM Contengono schiuma	TP-2160	0.7	TP-2300	1.4	I thermal pad HumiSeal® spessi hanno un supporto in schiuma e sono più morbidi e più comprimibili, sono quindi più adatti per applicazioni in cui la distanza tra i componenti è maggiore.
			TP-2101	0.7	

I Thermal Pad HumiSeal® sono venduti in rotoli, fogli o pezzi preformati su misura.
Chiedici tutte le misure disponibili!



Cabiotec



Cabiotec s.r.l. - Via R. Bitti,
6 - 20125 Milano



+39 02 6431832



sales@cabiotec.it



www.cabiotec.it

HumiSeal®